

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 華虹半導體有限公司

(于香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01347)

新聞稿

二零二四年第二季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2024年8月8日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：01347；上交所科创板證券代碼：688347）（“本公司”）於今日公佈截至二零二四年六月三十日止三個月的綜合經營業績。

二零二四年第二季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入 4.785 億美元，上年同期為 6.314 億美元，上季度為 4.600 億美元。
- 毛利率 10.5%，上年同期為 27.7%，上季度為 6.4%。
- 母公司擁有人應占溢利 670 萬美元，上年同期為 7,850 萬美元，上季度為 3,180 萬美元。
- 基本每股盈利 0.004 美元，上年同期為 0.060 美元，上季度為 0.019 美元。
- 淨資產收益率（年化）0.4%，上年同期為 10.0%，上季度為 2.0%。

二零二四年第三季度指引

- 我們預計銷售收入約在 5.0 億美元至 5.2 億美元之間。
- 我們預計毛利率約在 10% 至 12% 之間。

總裁致辭

公司總裁兼執行董事唐均君先生對 2024 年第二季度業績評論道：

“半導體市場正在經歷從底部開始的緩慢復蘇。在經歷了數個季度的持續疲軟後，市場在部分消費電子等領域的帶動下出現了企穩復蘇信號。2024 年第二季度，華虹半導體的銷售收入達到 4.785 億美元、符合指引，毛利率為 10.5%、優於指引，均實現了環比增長。產能利用率也較上季度進一步提升，已接近全方位滿產，鞏固了公司在特色工藝晶圓代工業界的領先地位。”

唐總繼續表示：“公司第二條 12 英寸生產線的建設正在緊鑼密鼓地推進中，預計年底前可以試生產，屆時公司的產能及特色工藝平臺將得到進一步的拓展和提升、挖掘出更大的潛力。華虹半導體將持續推進工藝技術的研發，不斷夯實並力爭擴大自身在特色工藝領域的優勢，為市場和廣大投資者帶來更出色的營運表現和更豐厚的投資回饋。”

電話會議公告

- 日期 2024年8月8日，星期四
- 時間: 17:00 香港/上海時間
05:00 美國東部時間
- 發言人: 唐均君，總裁兼執行董事
王鼎，執行副總裁兼首席財務官
- 廣播: 會議將在 http://www.huahonggrace.com/c/investor_webcast.php 或 <https://edge.media-server.com/mmc/p/xxyz2ewz> 作線上直播
(請提前註冊登記)
- 電話直撥: 請在會議前使用以下鏈接先進行註冊。註冊後，您將收到確認郵件獲得撥入號碼及 PIN (個人身份識別碼)。
<https://register.vevent.com/register/BI7aacc9bd162f42aaa1d911212b0f5476>
- 重要提示:** 在會議開始前，您需要使用確認郵件中提供的 PIN (個人身份識別碼) 才能進入會議。請在註冊後，注意查收並保存確認郵件。出於安全原因，請不要與任何人共享您的 PIN (個人身份識別碼)。
- 網上重播: 直播約 2 小時後，您可於 12 個月內在以下網頁重複收聽會議。
http://www.huahonggrace.com/c/investor_webcast.php

關於華虹半導體

華虹半導體有限公司 (A 股簡稱: 華虹公司, 688347; 港股簡稱: 華虹半導體, 01347) (“本公司”) 是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業, 秉持“8 英寸 + 12 英寸”、先進“特色 IC + Power Discrete”的發展戰略, 為客戶提供多元化的晶圓代工及配套服務。本公司專注於嵌入式/獨立式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理和邏輯與射頻等“8 英寸 + 12 英寸”特色工藝技術的持續創新, 有力支持新能源汽車、綠色能源、物聯網等新興領域應用, 其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員, 而華虹集團是中國擁有“8 英寸 + 12 英寸”先進集成電路製造主流工藝技術的產業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 8 英寸晶圓廠, 月產能約 18 萬片。另在無錫高新技術產業開發區內建有一座月產能 9.45 萬片的 12 英寸晶圓廠 (“華虹無錫”), 這不僅是全球領先的 12 英寸特色工藝生產線, 也是全球第一條 12 英寸功率器件代工生產線。目前, 本公司正在推進華虹無錫二期 12 英寸芯片生產線 (“華虹製造”) 的建設。

如欲取得更多公司相關資料, 請瀏覽: www.huahonggrace.com。

經營業績概要
(以仟美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零二四年 第二季度 (未經審核)	二零二三年 第二季度 (未經審核)	二零二四年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	478,524	631,381	459,986	(24.2)%	4.0 %
毛利	50,063	175,056	29,632	(71.4)%	68.9 %
毛利率	10.5 %	27.7 %	6.4 %	(17.2)	4.1
經營開支	(90,328)	(76,668)	(78,520)	17.8 %	15.0 %
其他收入/(損失)淨額	6,885	(54,709)	3,770	(112.6)%	82.6 %
稅前(損失)/溢利	(33,380)	43,679	(45,118)	(176.4)%	(26.0)%
所得稅(開支)/抵免	(8,368)	(35,845)	19,832	(76.7)%	(142.2)%
期內(損失)/溢利	(41,748)	7,834	(25,286)	(632.9)%	65.1 %
淨利潤率	(8.7)%	1.2 %	(5.5)%	(9.9)	(3.2)
以下各方應佔利潤:					
母公司擁有人	6,673	78,524	31,818	(91.5)%	(79.0)%
非控股權益	(48,421)	(70,690)	(57,104)	(31.5)%	(15.2)%
持有人應佔每股盈利					
基本	0.004	0.060	0.019	(93.3)%	(78.9)%
攤薄	0.004	0.060	0.019	(93.3)%	(78.9)%
付運晶圓(折合 8 吋仟片)	1,106	1,074	1,026	3.0 %	7.8 %
產能利用率 ¹	97.9 %	102.7 %	91.7 %	(4.8)	6.2
淨資產收益率 ²	0.4 %	10.0 %	2.0 %	(9.6)	(1.6)

二零二四年第二季度

- 銷售收入 4.785 億美元，上年同期為 6.314 億美元，主要由於平均銷售價格下降，上季度為 4.600 億美元，主要得益於付運晶圓數量上升。
- 毛利率 10.5%，上年同期為 27.7%，主要由於平均銷售價格下降，上季度為 6.4%，主要由於產能利用率提升。
- 經營開支 9,030 萬美元，同比上升 17.8%，主要由於新工廠華虹製造經營費用及研發工程片開支上升，環比上升 15.0%，主要由於人工開支增加。
- 其他收入淨額 690 萬美元，上年同期為其他損失淨額 5,470 萬美元，主要由於匯兌損失減少及利息收入增加，環比上升 82.6%，主要由於利息收入增加，部分被匯兌損失增加所抵消。
- 所得稅開支 840 萬美元，同比下降 76.7%，主要由於本季度應課稅利潤下降；上季度為所得稅抵免，主要由於上季度轉回以前年度計提的代扣代繳股息稅所致。
- 期內損失 4,170 萬美元，上年同期為期內溢利 780 萬美元，上季度為期內損失 2,530 萬美元。
- 母公司擁有人應佔溢利 670 萬美元，上年同期為期內溢利 7,850 萬美元，上季度為 3,180 萬美元。
- 基本每股盈利 0.004 美元，上年同期為 0.060 美元，上季度為 0.019 美元。
- 淨資產收益率（年化）0.4%，上年同期為 10.0%，上季度為 2.0%。

¹產能利用率按平均月約當產量除以總估計月產能計算。

²母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零二四年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第二季度 % (未經審核)	二零二三年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
晶圓	453,345	94.7 %	600,950	95.2 %	(147,605)	(24.6)%
其他	25,179	5.3 %	30,431	4.8 %	(5,252)	(17.3)%
銷售收入總額	478,524	100.0 %	631,381	100.0 %	(152,857)	(24.2)%

- 本季度 94.7% 的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按晶圓尺寸劃分的 銷售收入	二零二四年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第二季度 % (未經審核)	二零二三年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
8 吋晶圓	245,471	51.3 %	361,237	57.2 %	(115,766)	(32.0)%
12 吋晶圓	233,053	48.7 %	270,144	42.8 %	(37,091)	(13.7)%
銷售收入總額	478,524	100.0 %	631,381	100.0 %	(152,857)	(24.2)%

- 本季度來自於 8 吋晶圓和 12 吋晶圓的銷售收入分別為 2.455 億美元及 2.330 億美元。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零二四年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第二季度 % (未經審核)	二零二三年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
中國 ³	385,519	80.5 %	489,269	77.5 %	(103,750)	(21.2)%
北美 ⁴	46,829	9.8 %	48,547	7.7 %	(1,718)	(3.5)%
亞洲 ⁵	28,137	5.9 %	45,186	7.2 %	(17,049)	(37.7)%
歐洲	17,173	3.6 %	39,965	6.3 %	(22,792)	(57.0)%
日本 ⁶	866	0.2 %	8,414	1.3 %	(7,548)	(89.7)%
銷售收入總額	478,524	100.0 %	631,381	100.0 %	(152,857)	(24.2)%

- 本季度來自於中國的銷售收入 3.855 億美元，占銷售收入總額的 80.5%，同比下降 21.2%，主要由於智能卡芯片的平均銷售價格及需求下降，部分被邏輯、其他電源管理及 CIS 產品需求增加所抵消。
- 本季度來自於北美的銷售收入 4,680 萬美元，同比下降 3.5%，主要由於 MCU、邏輯、超級結及通用 MOSFET 產品的需求及平均銷售價格下降，部分被其他電源管理產品的需求增加所抵消。
- 本季度來自於亞洲的銷售收入 2,810 萬美元，同比下降 37.7%，主要由於 MCU、邏輯及超級結產品的平均銷售價格及需求下降。
- 本季度來自於歐洲的銷售收入 1,720 萬美元，同比下降 57.0%，主要由於智能卡芯片、IGBT 及通用 MOSFET 產品的需求下降。
- 本季度來自於日本的銷售收入 90 萬美元，同比下降 89.7%，主要由於 MCU 及超級結產品的需求下降。

³包括中國大陸及中國香港。

⁴包括於 2020 年由一家總部位於歐洲的公司所收購的一家主要美國客戶。

⁵不包括中國及日本。

⁶包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

銷售收入分析

按技術平台劃分的 銷售收入	二零二四年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第二季度 % (未經審核)	二零二三年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
嵌入式非易失性存儲器	137,126	28.7 %	208,265	33.0 %	(71,139)	(34.2)%
獨立式非易失性存儲器	23,675	4.9 %	33,360	5.3 %	(9,685)	(29.0)%
分立器件	152,371	31.8 %	251,351	39.8 %	(98,980)	(39.4)%
邏輯及射頻	63,487	13.3 %	57,175	9.1 %	6,312	11.0 %
模擬與電源管理	101,137	21.1 %	80,453	12.7 %	20,684	25.7 %
其他	728	0.2 %	777	0.1 %	(49)	(6.3)%
銷售收入總額	478,524	100.0 %	631,381	100.0 %	(152,857)	(24.2)%

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 1.371 億美元，同比下降 34.2%，主要由於 MCU 產品的平均銷售價格下降及智能卡芯片的需求下降。
- 本季度獨立式非易失性存儲器銷售收入 2,370 萬美元，同比下降 29.0%，主要由於閃存產品的平均銷售價格及需求下降。
- 本季度分立器件銷售收入 1.524 億美元，同比下降 39.4%，主要由於 IGBT、超級結產品的平均銷售價格及需求下降，以及通用 MOSFET 產品的平均銷售價格下降。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 6,350 萬美元，同比增長 11.0%，主要得益於 CIS 及邏輯產品的需求增加。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 1.011 億美元，同比增長 25.7%，主要得益於其他電源管理產品的需求增加。

銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零二四年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第二季度 % (未經審核)	二零二三年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
55nm 及 65nm	98,550	20.6 %	84,920	13.5 %	13,630	16.1 %
90nm 及 95nm	95,285	19.9 %	96,675	15.3 %	(1,390)	(1.4)%
0.11 μ m 及 0.13 μ m	68,660	14.3 %	120,254	19.0 %	(51,594)	(42.9)%
0.15 μ m 及 0.18 μ m	30,508	6.4 %	37,368	5.9 %	(6,860)	(18.4)%
0.25 μ m	2,436	0.5 %	6,319	1.0 %	(3,883)	(61.4)%
0.35 μ m 及以上	183,085	38.3 %	285,845	45.3 %	(102,760)	(35.9)%
銷售收入總額	478,524	100.0 %	631,381	100.0 %	(152,857)	(24.2)%

- 本季度 55nm 及 65nm 工藝技術節點的銷售收入 9,860 萬美元，同比增長 16.1%，主要得益於其他電源管理產品的需求增加。
- 本季度 90nm 及 95nm 工藝技術節點的銷售收入 9,530 萬美元，同比下降 1.4%，主要由於智能卡芯片需求減少，部分被其他電源管理產品需求增加所抵消。
- 本季度 0.11 μ m 及 0.13 μ m 工藝技術節點的銷售收入 6,870 萬美元，同比下降 42.9%，主要由於 MCU 產品的平均銷售價格及需求下降。
- 本季度 0.15 μ m 及 0.18 μ m 工藝技術節點的銷售收入 3,050 萬美元，同比下降 18.4%，主要由於 MCU 產品的平均銷售價格及需求下降。
- 本季度 0.25 μ m 工藝技術節點的銷售收入 240 萬美元，同比下降 61.4%，主要由於邏輯及通用 MOSFET 產品的需求及平均銷售價格下降。
- 本季度 0.35 μ m 及以上工藝技術節點的銷售收入 1.831 億美元，同比下降 35.9%，主要由於 IGBT、超級結及其他電源管理產品的需求及平均銷售價格下降，部分被通用 MOSFET 的需求增加所抵消。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零二四年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第二季度 % (未經審核)	二零二三年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
電子消費品	298,320	62.4 %	347,824	55.1 %	(49,504)	(14.2)%
工業及汽車	110,643	23.1 %	195,158	30.9 %	(84,515)	(43.3)%
通訊	59,486	12.4 %	68,412	10.8 %	(8,926)	(13.0)%
計算機	10,075	2.1 %	19,987	3.2 %	(9,912)	(49.6)%
銷售收入總額	478,524	100.0 %	631,381	100.0 %	(152,857)	(24.2)%

- 本季度電子消費品作為我們的第一大終端市場，貢獻銷售收入 2.983 億美元，占銷售收入總額的 62.4%，同比下降 14.2%，主要由於智能卡芯片及 IGBT 產品的平均銷售價格及需求下降，部分被其他電源管理產品的需求增加所抵消。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 1.106 億美元，同比下降 43.3%，主要由於 IGBT、MCU、通用 MOSFET、智能卡芯片及超級結產品的平均銷售價格及需求下降。
- 本季度通訊產品銷售收入 5,950 萬美元，同比下降 13.0%，主要由於邏輯及模擬產品的需求下降。
- 本季度計算機產品銷售收入 1,010 萬美元，同比下降 49.6%，主要由於通用 MOSFET 及超級結產品的需求及平均銷售價格下降。

產能⁷及產能利用率

晶圓廠(折合仟片晶圓)	二零二四年 第二季度 (未經審核)	二零二三年 第二季度 (未經審核)	二零二四年 第一季度 (未經審核)
產能 (200mm)	178	178	178
產能 (300mm)	95	75	95
合計產能(折合 8 吋仟片晶圓)	391	347	391
產能利用率 (200mm)	107.6%	112.0%	100.3%
產能利用率 (300mm)	89.3%	92.9%	84.2%
總體產能利用率	97.9%	102.7%	91.7%

- 本季度末月產能 391,000 片 8 吋等值晶圓。總體產能利用率為 97.9%，較上季度上升 6.2 個百分點。

⁷ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

付運晶圓

折合 8 吋矽片晶圓	二零二四年 第二季度 (未經審核)	二零二三年 第二季度 (未經審核)	二零二四年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
付運晶圓	1,106	1,074	1,026	3.0 %	7.8 %

- 本季度付運晶圓 1,106,000 片，同比上升 3.0%，環比上升 7.8%。

經營開支分析

以仟美元計	二零二四年 第二季度 (未經審核)	二零二三年 第二季度 (未經審核)	二零二四年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
銷售及分銷費用	2,785	2,402	1,985	15.9 %	40.3 %
管理費用 ⁸	87,543	74,266	76,535	17.9 %	14.4 %
經營開支	90,328	76,668	78,520	17.8 %	15.0 %

- 經營開支 9,030 萬美元，同比上升 17.8%，主要由於新工廠華虹製造經營費用及研發工程片開支上升，環比上升 15.0%，主要由於人工開支增加。

其他收入/(損失)淨額

以仟美元計	二零二四年 第二季度 (未經審核)	二零二三年 第二季度 (未經審核)	二零二四年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
租金收入	3,558	3,921	3,560	(9.3)%	(0.1)%
利息收入	29,787	14,057	25,020	111.9 %	19.1 %
匯兌損失	(7,921)	(62,646)	(5,850)	(87.4)%	35.4 %
分佔聯營公司溢利	1,394	1,984	1,411	(29.7)%	(1.2)%
財務費用	(24,847)	(28,287)	(24,585)	(12.2)%	1.1 %
政府補貼	4,778	14,213	3,799	(66.4)%	25.8 %
其他	136	2,049	415	(93.4)%	(67.2)%
其他收入/(損失)淨額	6,885	(54,709)	3,770	(112.6)%	82.6 %

- 其他收入淨額 690 萬美元，上年同期為其他損失淨額 5,470 萬美元，主要由於匯兌損失減少及利息收入增加，環比上升 82.6%，主要由於利息收入增加，部分被匯兌損失增加所抵消。

⁸管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

現金流量分析

以仟美元計	二零二四年 第二季度 (未經審核)	二零二三年 第二季度 (未經審核)	二零二四年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所得現金流量淨額	96,890	161,190	40,660	(39.9)%	138.3 %
投資活動所用現金流量淨額	(171,973)	(150,649)	(298,951)	14.2 %	(42.5)%
融資活動所得/(用)現金流量淨額	416,148	(300,183)	789,913	(238.6)%	(47.3)%
外匯匯率變動影響淨額	(25,185)	(77,948)	(8,817)	(67.7)%	185.6 %
現金及現金等價物變動影響淨額	315,880	(367,590)	522,805	(185.9)%	(39.6)%

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 9,690 萬美元，同比下降 39.9%，主要由於客戶收款及政府補助減少所致，環比上升 138.3%，主要由於客戶收款增加。
- 投資活動所用現金流量淨額 1.720 億美元，其中包括固定資產投資支出 1.968 億美元，部分被收到利息收入 2,480 萬美元所抵消。
- 融資活動所得現金流量淨額 4.161 億美元，其中非控股權益資本注資 4.924 億美元，提取銀行借款 9,900 萬美元，及員工行權發行股份收到 50 萬美元，部分被償還銀行借款本金 8,750 萬美元，支付利息 4,980 萬美元，支付股利 3,620 萬美元，及支付租賃負債 230 萬美元所抵消。

資本結構

以仟美元計	於六月三十日 二零二四年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二四年 (未經審核)
資產總額	12,104,780	11,648,010
負債總額	3,059,884	2,980,801
所有者權益總額	9,044,896	8,667,209
資產負債率 ⁹	25.3%	25.6%

資本開支

以仟美元計	二零二四年 第二季度 (未經審核)	二零二四年 第一季度 (未經審核)
華虹 8 吋	27,997	31,728
華虹無錫	40,431	71,417
華虹製造	128,402	199,429
合計	196,830	302,574

- 本季度資本開支 1.968 億美元，其中 1.284 億美元用於華虹製造，4,040 萬美元用於華虹無錫，及 2,800 萬美元用於華虹 8 吋。

⁹ 資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以仟美元計	於六月三十日 二零二四年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二四年 (未經審核)
發展中物業	207,151	194,181
存貨	462,563	431,206
貿易應收款項及應收票據	274,382	306,151
預付款項、其他應收款項及其他資產	75,761	53,242
應收關聯方款項	16,034	15,688
已凍結存款及定期存款	39,259	32,032
現金及現金等價物	6,423,866	6,107,986
流動資產總額	7,499,016	7,140,486
貿易應付款項	246,206	239,261
其他應付款項及暫估費用	505,945	379,133
計息銀行借款	247,034	232,201
租賃負債	4,674	6,257
政府補助	39,359	41,643
應付關聯方款項	8,340	9,704
應付所得稅	19,038	59,018
流動負債總額	1,070,596	967,217
淨營運資金	6,428,420	6,173,269
速動比率	6.4x	6.7x
流動比率	7.0x	7.4x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	55	58
存貨周轉天數	94	92

- 存貨由上季度末的 4.312 億美元上升至本季度末的 4.626 億美元，主要由於在製品增加。
- 貿易應收款項及應收票據由上季度末的 3.062 億美元下降至本季度末的 2.744 億美元，主要由於客戶回款改善。
- 預付款項、其他應收款項及其他資產由上季度末的 5,320 萬美元上升至本季度末的 7,580 萬美元，主要由於增值稅留抵稅額增加。
- 其他應付款項及暫估費用由上季度末的 3.791 億美元上升至本季度末的 5.059 億美元，主要由於應付資本開支增加。
- 應付所得稅由上季度末的 5,900 萬美元下降至本季度末的 1,900 萬美元，主要由於本季度支付 2023 年度應交所得稅，部分被本季度計提所得稅開支所抵消。
- 淨營運資金 本季度末 64.284 億美元，流動比率 7.0。
- 貿易應收款項及應收票據周轉天數 55 天。
- 存貨周轉天數 94 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com。

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以仟美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於六月三十日 二零二四年 (未經審核)	於六月三十日 二零二三年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二四年 (未經審核)
銷售收入	478,524	631,381	459,986
銷售成本	(428,461)	(456,325)	(430,354)
毛利	50,063	175,056	29,632
其他收入及收益	38,259	34,245	32,851
銷售及分銷費用	(2,785)	(2,402)	(1,985)
管理費用	(87,543)	(74,266)	(76,535)
其他費用	(7,921)	(62,651)	(5,907)
財務費用	(24,847)	(28,287)	(24,585)
分佔聯營公司溢利	1,394	1,984	1,411
稅前(損失)/溢利	(33,380)	43,679	(45,118)
所得稅(開支)/抵免	(8,368)	(35,845)	19,832
期內(損失)/溢利	(41,748)	7,834	(25,286)
以下各方應佔利潤			
母公司擁有人	6,673	78,524	31,818
非控股權益	(48,421)	(70,690)	(57,104)
持有人應佔每股盈利			
基本	0.004	0.060	0.019
攤薄	0.004	0.060	0.019
用於計算持有人應佔每股基本盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,716,917,408	1,308,028,146	1,716,634,650
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,720,532,998	1,318,619,081	1,718,334,991

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以仟美元計)

	截至		
	於六月三十日 二零二四年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二四年 (未經審核)	於六月三十日 二零二三年 (未經審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	3,750,176	3,587,363	3,256,562
投資物業	165,611	166,354	163,241
使用權資產	80,629	79,347	80,145
無形資產	42,320	46,526	31,170
於聯營公司的投資	141,036	140,270	129,414
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	285,938	287,089	151,812
長期預付款項	139,425	200,074	40,937
遞延稅項資產	629	501	17,393
非流動資產總額	4,605,764	4,507,524	3,870,674
流動資產			
發展中物業	207,151	194,181	143,674
存貨	462,563	431,206	558,252
貿易應收款項及應收票據	274,382	306,151	310,705
預付款項、其他應收款項及其他資產	75,761	53,242	32,194
應收關聯方款項	16,034	15,688	16,803
已凍結存款及定期存款	39,259	32,032	167,077
現金及現金等價物	6,423,866	6,107,986	1,850,957
流動資產總額	7,499,016	7,140,486	3,079,662
流動負債			
貿易應付款項	246,206	239,261	227,907
其他應付款項及暫估費用	505,945	379,133	397,826
計息銀行借款	247,034	232,201	385,746
租賃負債	4,674	6,257	4,477
政府補助	39,359	41,643	34,133
應付關聯方款項	8,340	9,704	4,720
應付所得稅	19,038	59,018	49,557
流動負債總額	1,070,596	967,217	1,104,366
流動資產淨額	6,428,420	6,173,269	1,975,296
總資產減流動負債	11,034,184	10,680,793	5,845,970
非流動負債			
計息銀行借款	1,964,956	1,993,525	1,410,544
租賃負債	19,440	17,714	18,312
遞延稅項負債	4,892	2,345	21,938
非流動負債總額	1,989,288	2,013,584	1,450,794
淨資產	9,044,896	8,667,209	4,395,176
權益和負債權益			
股本	4,935,470	4,934,028	1,997,829
儲備	1,333,799	1,389,777	1,130,367
本公司擁有人應佔權益	6,269,269	6,323,805	3,128,196
非控股權益	2,775,627	2,343,404	1,266,980
權益總額	9,044,896	8,667,209	4,395,176

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以仟美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於六月三十日	於六月三十日	於三月三十一日
	二零二四年 (未經審核)	二零二三年 (未經審核)	二零二四年 (未經審核)
經營活動所得現金流量：			
稅前(虧損)/溢利	(33,380)	43,679	(45,118)
折舊及攤銷	136,881	123,661	133,088
應佔聯營公司溢利	(1,394)	(1,984)	(1,411)
營運資金的變動及其它	(5,217)	(4,166)	(45,899)
經營活動所得現金流量淨額	96,890	161,190	40,660
投資活動所用現金流量：			
購買物業、廠房、設備及無形資產項目	(196,830)	(164,966)	(302,574)
投資其他權益工具	-	-	(17,618)
其他投資活動所得現金流量	24,857	14,317	21,241
投資活動所用現金流量淨額	(171,973)	(150,649)	(298,951)
融資活動所得/(用)現金流量：			
非控股權益資本注資	492,450	-	689,430
提取銀行貸款	99,042	8,116	103,405
發行股份所得收益	579	1,407	114
償還銀行貸款	(87,530)	(85,565)	-
已付利息	(49,800)	(52,720)	(2,155)
向股東支付股息	(28,876)	-	-
已抵押存款增加	(7,369)	(167,738)	-
支付租賃負債	(2,348)	(3,320)	(881)
其他融資活動所用現金流量	-	(363)	-
融資活動所得/(用)現金流量淨額	416,148	(300,183)	789,913
現金及現金等價物增加/(減少)淨額	341,065	(289,642)	531,622
外匯匯率變動影響淨額	(25,185)	(77,948)	(8,817)
期初現金及現金等價物	6,107,986	2,218,547	5,585,181
期末現金及現金等價物	6,423,866	1,850,957	6,107,986

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張素心(董事長)
唐均君(總裁)

非執行董事

葉峻
孫國棟
周利民
熊承艷

獨立非執行董事

張祖同
王桂壩太平紳士
封松林

承董事会命

華虹半導體有限公司

張素心
董事長兼執行董事

中國 香港

二零二四年八月八日